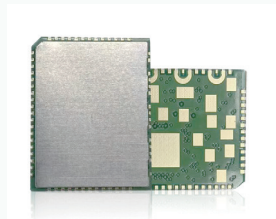


SLM215系列模组 (1.4/5Ghz)

现款: 37mm*49mm*7mm 新款: 28mm*35mm*3mm



SLM225系列模组 (2.4/5Ghz)

23mm*29mm*2.7mm

无线技术特点

- 基于 OFDM 和 MIMO 等关键技术，提高频谱效率。
- 支持 1T1R、1T2R、2T2R 收发模式。
- 支持 16QAM/QPSK/BPSK 的调制模式。
- 支持1.25MHz/2.5MHz/5MHz/10MHz/20MHz/40MHz 的信道带宽。
- 支持 AES 加密，支持多种安全策略，防止非法监听与截获。
- 支持频道自适应选择方案，实时监控信道质量和无线干扰情况，自动选择通信频道。
- 基于 HARQ 技术和物理层资源预留机制，提供端到端（含中继）无线通信的QoS保障。
- 支持 1000km/h 高速移动性连接。
- 点对点空口传输最高速率可达 160Mbps。

自组网技术特点

- 自组网节点数量≤256 个。
- 自动监测节点之间无线信号质量，动态维护节点拓扑结构。
- 支持任何时刻往任意节点发送小数据消息。
 - 非 TCP/IP，通常小于 1KB 字节的数据包；
 - 小数据总带宽约 200Kbps，由所有节点分享。
- 并发支持两路宽带大数据通路。
 - 使用 TCP/IP 协议，数据率 1Mbps~12Mbps 可配置，典型为 4.4Mbps。
 - 自动建立 R 节点和 N 节点之间的多跳通路，支持最多 255 跳。



SLC80系列

8mm*8mm*0.85mm

- 集成RF、基带、CPU
- 支持150M~7GHz
- 支持1T1R, 1T2R, 2T2R
- 最大空口数据率200Mbps
- 支持网口、USB和其他各种常用数据接口
- 内置硬件AES/DES/3DES加解密和RSA签名模块
- 支持无线测距和自组网定位
- 支持最高256个节点的自组网

SOC芯片

通过先进的芯片制造工艺，集成自研RF、基带、CPU，实现了高性能、低功耗、小尺寸、低成本结合。

低时延

通过基带和协议栈的优化设计，每增加一跳的时延最低仅6ms，支持最多255跳中继。

高安全性

基于芯片内的加密引擎，支持用硬件ID和安全证书进行接入认证、支持信道加密。支持主动跳频，可以实现更高的安全性。

高可靠性

通过并发信道评估、缩小无线资源控制的颗粒度利用动态自适应频道选择等方法，在非授权频段获得媲美授权频段的可靠性，无需复杂规划，部署和使用方便。

低功耗

高集成度芯片是低功耗的基础，通过优化的协议栈进一步降低功耗，通过窄带融合，实现超低功耗支持电池供电的长时间运行。

移动性

通过并发的信道动态评估、智能调度决策、抗多普勒频偏、连接平滑切换等技术，支持无人机在1000km/h的相对速度飞行时，进行拓扑结构的动态调整。



SLC90系列

18mm*13mm*2.1mm

- 合封SLC80系列芯片，继承其各项功能和性能
- 合封FEM、PMU、晶振、阻容等器件
- 支持2.4G / 5~6G / 6~6.5G频段（视规格）
- 发射功率18dBm / 23dBm / 26dBm（视规格）
- 支持不超过256个节点的自组网

